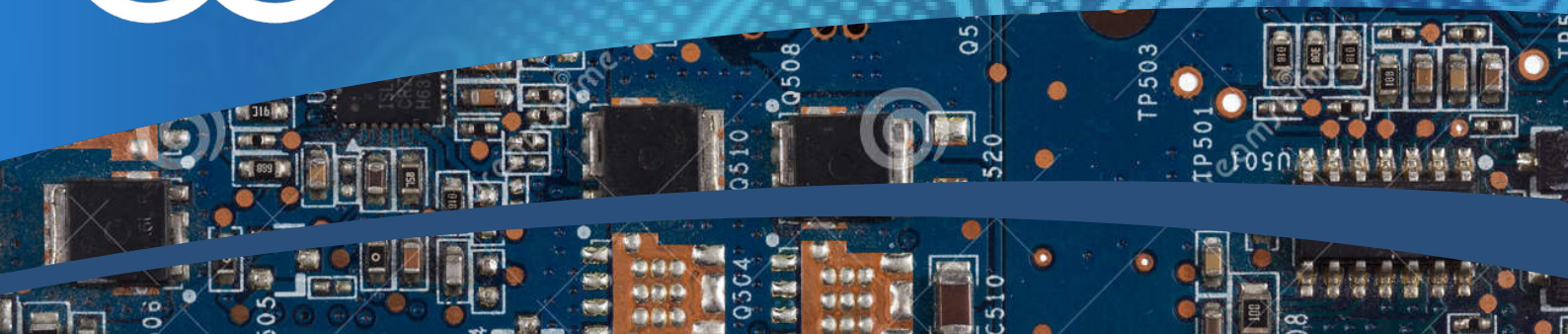




The European Institute for the PCB Community

# Technical Snapshot

## BadHomburg, Deutschland



**Datum: 27. November, 2018**

**Standort: Hirschgarten, Bad Homburg**

**Tagesordnung**  
**Deutsche Sprache**

**10:00-Vortrag 1**

- EIPC/Multiline International Europa GmbH-Paul Waldner  
Anwendungen von Flex und Starr-flex Schaltungen in der Industrie

**10:30- Vortrag 2**

- Schoeller Electronics Systems GmbH-Markus Wille  
Entwicklung von Smart Integrated Systems mit Hilfe von flexiblen und starrflexiblen Leiterplatten

**11:15-Vortrag 3**

- DuPont-Manfred Grimmeisen  
Materialien für Rigid-Flex-Leiterplatten

**12:00 Lunch**

**13:30-Vortrag 4**

- Taiyo-Lisa Kennedy  
Das Design von einer flexiblen DI Loettstopmmaske als Ersatz von Deckfolien

**14:15-Vortrag 5**

- Dyconex-Hubert Zimmermann  
Mehr Funktionalitaet durch ultraduenne Materialien

**15:00-Vortrag 6**

- Ilfa-Christian Behrendt  
Fertigungsaufwandes verschiedener StarrFlex Fertigungstechnologien

**15:45-7**

- Panel Discussion and Closing Comments



Fachverband für Design,  
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

*Please visit*

[www.eipc.org](http://www.eipc.org)

*for the latest news*

For more information contact EIPC:  
PO Box 610  
NL-6160 AP Geleen  
Phone +31-46-4264258  
[eipc@eipc.org](mailto:eipc@eipc.org)  
[www.eipc.org](http://www.eipc.org)

PressSponsors:

